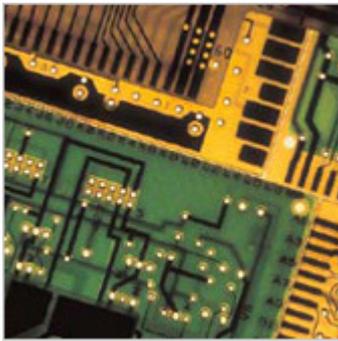


## 助焊液



在电子工业的众多领域，DOW 陶氏 UCON™流体非常适合于作为各种应用的基础液（包括助焊液）。陶氏水溶性 UCON 流体具有出色的热稳定性和氧化稳定性，是制造与组装印刷电路板所用助剂的理想选择。经过抑制的流体具有高温稳定性、高闪点和高燃点以及低起泡性等优异特性。

产品	描述	40°C 下的粘度
UCON Solder Assist Fluids 10	一种高闪点、水溶性 PAG 基础流体，具有良好的内在热稳定性和水冲洗性，非常适合用作回流焊接液、助焊及助熔剂的组分。	280
UCON Solder Assist Fluids 24	一种中等粘度的 PAG 基础流体，具有良好的固有热稳定性和水洗性，非常适合用作回流焊接液、助焊及助熔剂的组分。	123
UCON Solder Assist Fluids 25	一种低粘度、水溶性 PAG 基础流体，具有良好的热稳定性和水洗性，非常适合用作回流焊接液、助焊及助熔剂的组分。	90
UCON Solder Assist Fluids 26	一种低粘度、水溶性 PAG 基础流体，可用作添加剂以提高高温条件下的稳定性与闪点，并且非常适合用作回流焊接液、助焊及助熔剂的组分。	90